

基板実装組立 おまかせください!!

回路、基板設計データをいただければ
当社特約協力工場で量産まで代行納品!!



- 基板実装をアウトソーシングしたい!!
量産の為の検査治具等も製作します!!
- 小ロット品や試作基板も対応!!
- 回路設計などの開発業務も可能!!



■受託仕様

受託形態	サービス内容	見積り項目
生基板供給	お客様のご要求に基づく生基板のみのご提供	生基板単価 (ロット、年間要求枚数条件)
基板実装量産受託	回路設計、基板設計 データをご提供頂き当社で量産受託	メタルマスク費、金型費 検査治具費、量産品単価
基板設計量産受託	回路設計、データをご提供頂き、 量産の為に基板設計と量産を受託	基板設計費、メタルマスク費 金型費、検査治具費、量産品単価
開発量産受託	お客様から商品要求条件書を頂き、 当社で回路及び基板設計開発、更に量産まで受託	回路・基板設計開発費 メタルマスク費、金型費 検査治具費、量産品単価

- 注意**
- 開発費は試作品納入までの費用を頂きます。
 - 2次試作が必要な場合は、追加開発費をお見積りさせていただきます。
 - 開発中、追加仕様や要求仕様が変更になった場合は、追加開発費の発生と納期が遅れることがあります。
 - 開発が途中で中断する場合は、その時点までにかかった工数費をご請求させていただきます。
 - 人命に関わる機器、原子炉、防衛機器などの高度重要機器の開発は、お請けする事が出来ません。予めご了承下さい。
 - 回路・基板設計、開発にあたっては商品要求条件(仕様)書をまず頂く必要があります。

■基板仕様

基板サイズ	仕様	コーティング	積層基板	規格
数センチ×数センチ ～A4サイズ程度	BGA基板、アルミ フレキシ基板、セラミック他	表面コーティング ポッティング	多面、両面基板 多層基板	RoHS (CE、UL、CCC)

- 注意**
- UL、CE、CCC規格については別途ご相談ください。
 - ご要求仕様によっては、お請け出来ないことがあります。
 - 基本、国内特約工場にて組立実装致します。
 - 納品時、梱包形態は一般梱包仕様となります。真空パックなどの特殊梱包は別途ご相談させていただきます。
 - 特殊検査(X線他)を希望される場合は、別途ご相談させていただきます。

株式会社 オリナス

東京営業所 〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル
TEL:03-5715-1141(代) FAX:03-5715-1142

名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄1-10-21 名古屋御園ビル
TEL:052-857-1210(代) FAX:052-857-1213

京都営業所 〒600-8231 京都市下京区堀川通七条下 井筒堀川ビル
TEL:075-342-1600(代) FAX:075-342-1650

大阪営業所 〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル14F
TEL:06-6341-1600(代) FAX:06-6341-1610

本社 〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル14F
TEL:06-6341-1600(代) FAX:06-6341-1610

ただいまオリナスニュース好評配信中! ホームページ <http://www.olinac.co.jp>